

出展のご案内

Booth No. **1619**

ハイブリッドマテリアルの総合砥粒加工装置

FOWLP, PLP, TSV ウェーハの研削

～半導体及び先端パッケージ技術の進化への対応～

FOWLP/PLP研削におけるCu+モールド樹脂加工
及び複合材平坦化技術により、IoT社会の実現へ貢献します

加工実例 積層技術に対応した、パッケージ材料、TSVウェーハ
様々な樹脂・金属・膜の複合素材



次世代高周波通信
デバイス用
ハイブリットウェーハ

ハイブリットウェーハ
(異種材料基板)
の総合砥粒加工装置

TSV 積層ウェーハ

オートTTVコントロールによる
高精度研削

電子部品用
各種セラミックス材料

BGテープ高精度研削

バンブウェーハの高精度加工

次世代 パワーデバイス用材料

SiC, GaN, C(ダイヤモンド)